

Lundi 3	Mardi 4 juin	Mercredi 5 juin	Jeudi 6 juin	Vendredi 7 juin
	8:30 – 10:00			
		8:30 – 10:00	8:30 – 10:00	8:30 – 10:00
	8:30 – 9:00 <i>Ouverture et présentation de l'atelier</i> 9:00- 10:00 <i>Failure analysis 4.0 : Une réelle opportunité</i>	Session 3 Packaging PCB & Assemblages	Micro-atelier 2 Préparation des échantillons	Session 5 Analyse de défaillance des composants opto-électroniques et hyperfréquences
			Micro-atelier 5 Packaging PCB et assemblages	Tutoriel 6 Les mesures thermiques : techniques et exemples
				Micro-atelier 7 Contrefaçon ou défaut de fabrication ?
11h	10:15 – 12:15	10:30 – 12:00	10:30 – 12:00	10:15 – 12:00
Ouverture de l'accueil	Tutoriel 3 <i>Partie 1</i> Les composants passifs : techno et analyse de défaillance	Session 1 Analyse de défaillance des composants de puissance (Si, SiC, GaN)	Session 3 Packaging PCB & Assemblages	Micro-atelier 2 Préparation des échantillons
			Tutoriel 4 Techniques d'analyses non destructives : RX, SAM...	Micro-atelier 5 Packaging PCB et assemblages
				Open questions
				Micro-atelier 7 Contrefaçon ou défaut de fabrication ?
12h00/14h00 Déjeuner	Déjeuner	Déjeuner	Déjeuner	12:00 – 12:30 : Bilan
14h00-16h00	14:00 – 16:00	14:00 – 16:00	14:00 – 16:00	Déjeuner
Tutoriel 1 Assemblages électroniques	Tutoriel 3 <i>Partie 2</i> Les composants passifs : techno et analyse de défaillance	Session 2 Analyse des circuits intégrés VLSI : défaillances, robustesse, sécurité	Micro-atelier 3 Apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse de défaillance	Session 4 Analyse de défaillance des composants passifs
			Tutoriel 5 Composants de puissance SiC et GaN : fabrication et analyse de défaillance	Session 6 Défiabilisation des composants dans le process industriel ou en utilisation
				14:00 : Départ
				<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>ATELIER 2024</h2> <h3>19^{ème} atelier</h3> <h1>ANADEF</h1> </div>
16:30 – 18:00	16:30 – 18:00	16:30 – 18:00	16:30 – 18:00	
Tutoriel 2 Fabrication des PCB	Open questions	Micro-atelier 1 Impact normes et législations (Reach, RoHs)	Session 3 Packaging PCB & Assemblages	
			Open questions	Micro-atelier 6 Contrôle non destructif
	Soirée fournisseurs			